

Wir gehen in die Tiefe 2018

Dresden | 27. und 28. Juni 2018



Vorläufige Agenda

Stand: 19.06.2018

Mittwoch, 27.06.2018

- 09.15 Uhr Laser-Nutzentrennen – Technologien und Trends beim Einsatz von Lasern zum Trennen von modernen Leiterplatten
Referent: Günter Lorenz, ASYS Automatisierungssysteme GmbH
- 10.00 Uhr Smart Sensors in Reflowanlagen
Referent: Paul Wild, Rehm Thermal Systems GmbH
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr Individuelle Lösungen für Sonderprozesse in der SMT
Referent: Thomas Mückl, Zollner Elektronik AG
- 12.15 Uhr Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – Kontrolle in der elektronischen Baugruppenfertigung
Referent: Andreas Kraus, Kraus Hardware GmbH
- 13.00 Uhr Mittagessen
- 14.00 Uhr SMT Smart Factory – Vertikale und horizontale Integration, aber nur mit Standards
Referent: Thomas Marktscheffel, ASM Assembly Systems
- 14.45 Uhr Kaffeepause
- 15.15 Uhr Herausforderungen bei der Verarbeitung von modernen SOT und SOD Bauteilformen
Referent: Christoph Hippin, Endress+Hauser GmbH+Co. KG
- 16.00 Uhr Ende des ersten Seminartages
- 18.00 Uhr „Networking“ - Abfahrt vor dem Hotel

Donnerstag, 28.06.2018

- 09.00 Uhr Neue Verbindungen aufbauen mit RFID – vom Bestückprozess zum End-of-Life
Referent: Alexander M. Schmoltdt, Murata Europe
- 09.45 Uhr Nokias conscious factory concept
Referent: Claus Heller, Nokia (Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG)
- 10.15 Uhr Kaffeepause
- 11.00 Uhr Whisker-Mitigationskonzepte für Avionik- und hochzuverlässige Elektronikprodukte
Referent: Thomas Lauer, HENSOLDT
- 11.45 Uhr Strategien zur Reduktion von Residues in Konvektionslötssystemen
Referent: Dipl.-Ing. Ralf Heidenreich, Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbH
- 12.30 Uhr Mittagessen
- 13.30 Uhr Elektrochemischer Siebdruck zur Strukturierung dünner Metallschichten
Referent: Dr. rer. nat. Mathias Kamp, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
- 14.15 Uhr Integrierte Heizstrukturen in Leiterplatten
Referent: Prof. Mathias Nowotnick, Dirk Seehase, Universität Rostock
- 15.00 Uhr Ende der Veranstaltung